

Д. т. н. А. И. КАЗАКОВ, к. ф.-м. н. А. В. АНДРИЯНОВ,  
В. С. МИРОНОВ, к. т. н. О. В. ПОЛЯРУШ

Украина, Одесский национальный политехнический университет  
E-mail: elin@rtf.ospu.odessa.ua

Дата поступления в редакцию  
05.04—18.10 2002 г.  
Оппоненты к. т. н. А. Ф. АНДРЕЕВА,  
к. х. н. А. В. ШЕВЧЕНКО  
(ИПМ НАНУ, г. Киев)

## РАСЧЕТ ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ ПЛЕНОК СИСТЕМЫ $HfO_2-Nd_2O_3$

*На примере системы  $HfO_2-Nd_2O_3$  показана применимость предложенной методики для оптимизации свойств получаемых диэлектрических пленок.*

На современном этапе развития микроэлектронной техники все более жесткие требования предъявляются к качеству диэлектрических пленок, особенно к воспроизводимости их характеристик и параметров. Для тонкопленочных электролюминесцентных структур (ТПЭЛС) оптимальным набором свойств обладают пленки системы  $HfO_2-Nd_2O_3$ , которые имеют хорошие диэлектрические и оптические характеристики, высокую электрическую прочность и термополевую стабильность [1]. Однако применение пленок системы  $HfO_2-Nd_2O_3$  в пленочной микроэлектронике во многом ограничивается отсутствием данных об их свойствах. В то же время методы математического моделирования позволяют прогнозировать электрофизические характеристики получаемых пленок.

Для улучшения характеристик ТПЭЛС необходимо оптимизировать параметры используемых диэлектрических пленок ТПЭЛС таким образом, чтобы в области применяемых рабочих частот устройства (обычно 50 Гц — 10 кГц) они обладали максимальным значением диэлектрической проницаемости  $\epsilon$  и минимальным значением тангенса угла диэлектрических потерь  $\operatorname{tg}\delta$ .

Целью данной работы является разработка методики расчета частотной зависимости таких диэлектрических характеристик как  $\epsilon$  и  $\operatorname{tg}\delta$  тонких пленок системы  $HfO_2-Nd_2O_3$ , полученных электронно-лучевым испарением. Одним из основных преимуществ этих оксидных систем является возможность образования квазибинарных твердых растворов, что позволяет синтезировать новые материалы с заданным изменением свойств.

С термодинамической точки зрения, в многокомпонентных оксидных системах на основе редкоземельных и переходных металлов можно ожидать значительные энергетические эффекты смешения, что должно приводить к нелинейной зависимости свойств таких фаз от состава.

При испарении в вакууме смесей оксидов редкоземельных элементов наблюдается заметное отклонение состава получаемой пленки от состава испаряемого материала. Установлено, что при испарении смеси оксидов гафния и лантана происходит обеднение

растущей пленки гафнием, а поверхностный слой пленки обогащается  $HfO_2$  [2]. При получении тонких пленок в системе  $HfO_2-Nd_2O_3$  распределение концентраций компонентов по толщине пленки носит нелинейный характер и может быть достаточно резким [1]. Это можно объяснить тем, что растворимость  $Nd_2O_3$  в моноклинной и тетрагональной окиси гафния незначительна [3, с. 176].

Однако установлено, что кубическая высокотемпературная модификация  $HfO_2$  может быть стабилизирована путем добавления редкоземельных оксидов в концентрациях более чем 5 мас.%. При этом образуются протяженные гетерогенные области существования кубических твердых растворов на основе высокотемпературных полиморфных модификаций  $HfO_2$  и  $Nd_2O_3$  типа флюорита и пирохлора. Эти фазы могут быть метастабильными при низких температурах вследствие неравновесных условий осаждения и стабилизирующего влияния размерных эффектов в тонких пленках.

**Описание диэлектрических свойств подобных неоднородных по толщине тонких пленок возможно на основе теории многослойного конденсатора Максвелла [4, с. 106].** Для изучаемого случая в качестве первого приближения можно представить получаемые тонкие пленки  $HfO_2-Nd_2O_3$  как двухслойные, в которых приповерхностный слой обогащен  $HfO_2$ , а внутренний слой имеет состав, близкий к составу испаряемого источника. Тогда расчет частотной зависимости диэлектрических характеристик возможен на основе модели двухслойного конденсатора. Структура исследуемых образцов и соответствующая эквивалентная схема представлены на рис. 1.

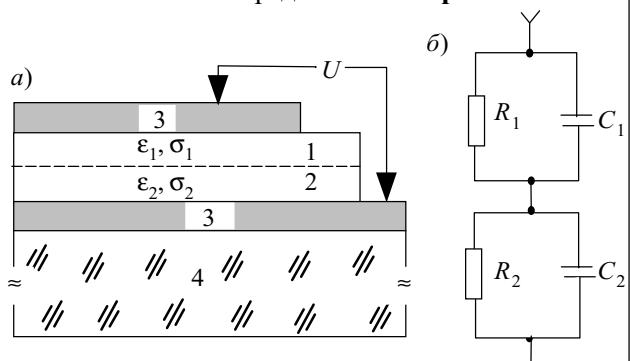


Рис. 1. Структурная (а) и эквивалентная (б) схемы МДМ-структуры на основе диэлектрических пленок  $HfO_2-Nd_2O_3$ :

1 — поверхностный слой, обогащенный  $HfO_2$ ; 2 — слой  $HfO_2-Nd_2O_3$ , близкий к составу испаряемого материала; 3 — пленка Al; 4 — стеклянная подложка

## МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Составляющие результирующей комплексной диэлектрической проницаемости пленки  $\epsilon = \epsilon_r - i\epsilon'$  для используемой модели могут быть записаны как [4]:

$$\epsilon_r = \frac{(\tau_1 + \tau_2) - \tau(1 - \omega^2 \tau_1 \tau_2)}{C_0(R_1 + R_2)(1 + \omega^2 \tau^2)}, \quad (1)$$

$$\epsilon' = \frac{1 - \omega^2 \tau_1 \tau_2 + \omega^2 \tau(\tau_1 + \tau_2)}{\omega C_0(R_1 + R_2)(1 + \omega^2 \tau^2)}, \quad (2)$$

$$\text{где } \tau_1 = R_1 C_1 = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0}{\sigma_1}; \quad \tau_2 = R_2 C_2 = \frac{\epsilon_2 \epsilon_0}{\sigma_2};$$

$R_1, R_2$  — сопротивление;

$\sigma_1, \sigma_2$  — проводимость;

$C_1, C_2$  — емкость;

$\epsilon_1, \epsilon_2$  — диэлектрическая проницаемость соответствующих слоев;

$\epsilon_0$  — электрическая постоянная;

$$\tau = \frac{R_1 \tau_2 + R_2 \tau_1}{R_1 + R_2} = \frac{(d_1 \epsilon_2 + d_2 \epsilon_1) \epsilon_0}{d_1 \sigma_2 + d_2 \sigma_1};$$

$d_1$  — толщина поверхностного слоя, обогащенного  $\text{HfO}_2$ ;

$d_2$  — толщина слоя с составом, соответствующим составу испаряемого материала;

$\omega$  — циклическая частота;

$$C_0 = \frac{S}{(d_1 + d_2)};$$

$S$  — площадь МДМ-структур.

Тангенс угла диэлектрических потерь для двухслойной модели можно записать как

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{\epsilon'}{\epsilon_r} = \frac{1 - \omega^2 \tau_1 \tau_2 + \omega^2 \tau(\tau_1 + \tau_2)}{\omega[(\tau_1 + \tau_2) - \tau(1 - \omega^2 \tau_1 \tau_2)]}. \quad (3)$$

Для проверки применимости модели двухслойного конденсатора была разработана экспериментальная методика получения пленок с составами, соответствующими начальной и конечной стадии процесса напыления. Исследования проводились на МДМ-структурах с тонкой диэлектрической пленкой системы  $\text{HfO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$ , которую наносили электронно-лучевым испарением из таблетированных мишней на стеклянные подложки в вакууме  $3 \cdot 10^{-3}$  Па. Технологические режимы осаждения были аналогичны приведенным в [1, 5].

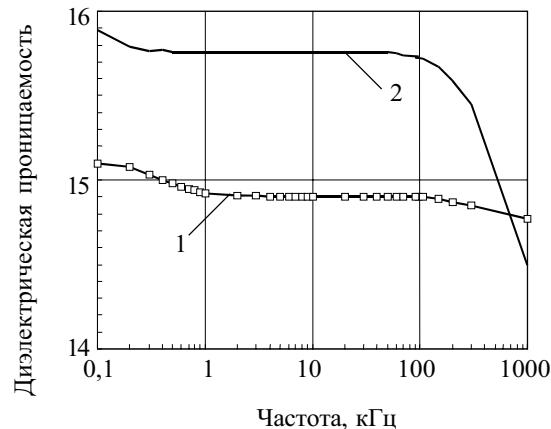


Рис. 2. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости пленок системы  $\text{HfO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$  (25%):

1 — эксперимент; 2 — модель

Осаждение пленки диэлектрика на подложки с предварительно напыленной проводящей пленкой проводилось с пошаговым перемещением заслонки одновременно в режимах "открывающаяся заслонка" и "закрывающаяся заслонка". При этом получалась ступенчатая конфигурация структуры с различным составом пленки. В случае режима "открывающаяся заслонка" ступенчато уменьшается толщина слоя пленки с составом, близким к составу испаряемого материала, вплоть до слоя, обогащенного  $\text{HfO}_2$ . Эти образцы позволяют оценить состав пленки, получаемой на конечной стадии. И наоборот, в случае режима "закрывающаяся заслонка" ступенчато увеличивается толщина слоя пленки с составом, близким к составу испаряемого материала, вплоть до толщины пленки, содержащей поверхностный слой, обогащенный  $\text{HfO}_2$ , что позволяет оценить состав пленок, получаемых на начальной стадии процесса.

В качестве электродов использовались алюминиевые пленки, получаемые резистивным испарением через маску в вакууме  $5 \cdot 10^{-3}$  Па. На подложке размером  $60 \times 48$  мм формировались 400 МДМ-структур размером  $1 \times 1$  мм. Исследования проводились на участках с равной толщиной пленки диэлектрика.

Измерения диэлектрических параметров проводились на соответствующих МДМ-структурах. Значения  $\epsilon_1, \sigma_1$  измерялись на МДМ-структуре толщиной  $d_1$  с диэлектрическими параметрами, близкими к  $\text{HfO}_2$ ,  $\epsilon_2, \sigma_2$  — на структуре толщиной  $d_2 = d - d_1$  ( $d$  — общая толщина слоя) и составом пленки, близким к составу испаряемого материала.

В процессе роста толщина пленок контролировалась по методике, основанной на интерференции лазерных лучей. Скорость осаждения пленки диэлектрика была постоянной и стабильной и составляла 5 нм/мин, а толщина варьировалась в интервале 60...400 нм. Итоговый контроль толщины пленок проводился с помощью интерферометра МИИ-4. Значение  $d_1$  в среднем составляло порядка 40 нм, а  $d_2 = 260$  нм. Измерения емкости и диэлектрических потерь на разных частотах проводились мостом полных проводимостей типа МПП-300 и измерителями E7-8, E7-11, E7-12.

Экспериментальная зависимость получена усреднением результатов измерений на 5 подложках, каждая из которых содержала 400 МДМ-структур. На

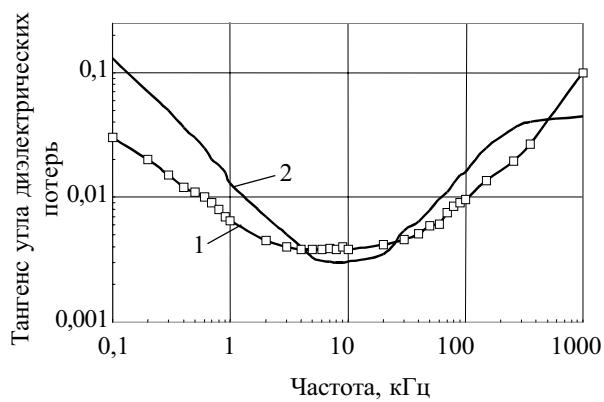


Рис. 3. Частотная зависимость  $\operatorname{tg}\delta$  пленок системы  $\text{HfO}_2 - \text{Nd}_2\text{O}_3$  (25%):

1 — эксперимент; 2 — модель

## МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

**рис. 2 и 3** показаны частотные зависимости соответственно диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь пленок  $\text{HfO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$  (25 мас.-%), измеренных и построенных в соответствии с результатами расчета по формулам (1) — (3) на основе данных, полученных на ступенчатых структурах.

Оценка адекватности используемой математической модели проводилась на основе критерия Фишера  $F$ , который определялся как отношение дисперсии адекватности модели к дисперсии воспроизведимости технологического процесса. Для модели, описывающей диэлектрическую проницаемость, величина  $F$  составляла 5,54 и для модели, описывающей тангенс угла диэлектрических потерь, — 5,67. Критическое значение критерия Фишера  $F_{kp}$  для уровня значимости 0,05 составляет 5,8 [6, с. 166]. Поскольку и в том, и в другом случае выполняется соотношение  $F < F_{kp}$ , можно сделать вывод о том, что модель двухслойного конденсатора достаточно хорошо описывает частотную зависимость  $\epsilon$  и  $\operatorname{tg}\delta$  для исследуемого материала.

С физической точки зрения наблюдаемые расхождения между моделью и экспериментальными данными для  $\epsilon$  и  $\operatorname{tg}\delta$  на высоких частотах можно объяснить тем, что для исследуемого материала ионно-релаксационный тип поляризации, который предполагается основным в теории многослойного конденсатора Максвелла, на высоких частотах уже не является доминирующим, и оказывается заметное влияние других видов поляризации, в результате чего наблюдается более медленное снижение величины диэлектрической проницаемости при повышении частоты.

Данные расчета были использованы для оптимизации параметров ТПЭЛС с диэлектрической пленкой системы  $\text{HfO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$ . Это позволило повысить электрофизические и оптические характеристики тонкопленочных излучателей.

\*\*\*

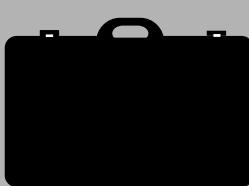
Предложенная методика расчета диэлектрических параметров пленок системы  $\text{HfO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$  позволяет с достаточной достоверностью прогнозировать их характеристики в широком частотном диапазоне. Использование описанной методики позволяет существенно сократить масштабы технологического эксперимента при оптимизации параметров диэлектрических пленок многокомпонентных систем в соответствии с практическими требованиями.

### ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Сухарев Ю. Г., Акулюшин И. Л., Миронов В. С. и др. Электрофизические свойства пленок систем  $\text{ZrO}_2\text{—Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{HfO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$ ,  $\text{HfO}_2\text{—Y}_2\text{O}_3$  // Неорган. матер.— 1994.— Т. 30, № 4.— С. 556—558.
2. Ходос М. Я., Тетерин Г. А., Журавлев Ю. Ф. и др. Вакуумные конденсаторы систем  $\text{HfO}_2\text{—Ln}_2\text{O}_3$  // Там же.— 1990.— Т. 26, № 11.— С. 2332—2334.
3. Глушкова В. Б., Кравчинская М. В., Кузнецов А. К., Тихонов П. А. Диоксид гафния и его соединения с оксидами редкоземельных элементов.— Л.: Наука, 1984.
4. Окадзаки К. Пособие по электротехническим материалам.— М.: Энергия, 1979.
5. Сухарев Ю. Г., Бойко В. А., Цацко В. И. и др. Получение и диэлектрические свойства пленок оксидов редкоземельных элементов // Электронная техника. Сер. Материалы.— 1987.— Вып. 4.— С. 62—65.
6. Чарыков А. К. Математическая обработка результатов химического анализа.— Л.: Химия, 1984.

### в портфеле редакции    в портфеле редакции    в портфеле редакции    в портфеле редакции

- в портфеле редакции    в портфеле редакции    в портфеле редакции    в портфеле редакции
- Оценка технологического процесса изготовления СБИС по стабильности элементов ее структуры.  
*А. М. Вантеев, А. И. Коробов (Россия, г. Москва)*
  - Радиационное легирование сульфида кадмия и арсенида галлия. *В. А. Мокрицкий, А. С. Гаркавенко, В. В. Зубарев, С. В. Ленков (Украина, гг. Одесса, Львов, Киев)*
  - Оптико-электронный дальномер малых дистанций для динамических систем. *Ю. Ф. Ваксман, В. И. Сатоний, В. В. Янко, И. А. Иванченко, Л. М. Будиянская (Украина, г. Одесса)*
  - Приборы определения солености воды на основе индуктивных балансных сенсоров. *О. Н. Негоденко, С. А. Черевко (Россия, г. Таганрог)*
  - Определение информативных параметров импульсных сигналов при контроле качества композиционных материалов. *В. С. Еременко, С. И. Еременко (Украина, г. Киев)*
  - Люминесцентные и фотоэлектрические характеристики структур на основе гетероперехода "кремний — арсенид галлия". *Л. Л. Терлецкая, Л. Ф. Калиниченко, В. В. Голубцов (Украина, г. Одесса)*
  - Исследование закономерностей и моделирование процессов бесконтактного химико-механического изготовления полупроводников. *Н. Н. Григорьев, М. Ю. Кравецкий, Г. А. Пащенко, С. О. Сылко, А. В. Фомин (Украина, г. Киев)*
  - Влияние кремниевой подложки на пробивное напряжение разветвленного  $n^{++} — p^+$ -перехода. *В. П. Сидоренко, А. Ю. Кизяк, Ю. Е. Николаенко (Украина, г. Киев)*
  - Определение диаметра луча с помощью фотоприемника. *Л. Ф. Викулина, В. А. Мингалев (Украина, г. Одесса)*



### редакции в портфеле редакции    в портфеле редакции    в портфеле редакции    в портфеле

в портфеле редакции    в портфеле редакции    в портфеле редакции